

5120677-1 ✓ 有效

Z-PACK | Z-PACK HS3

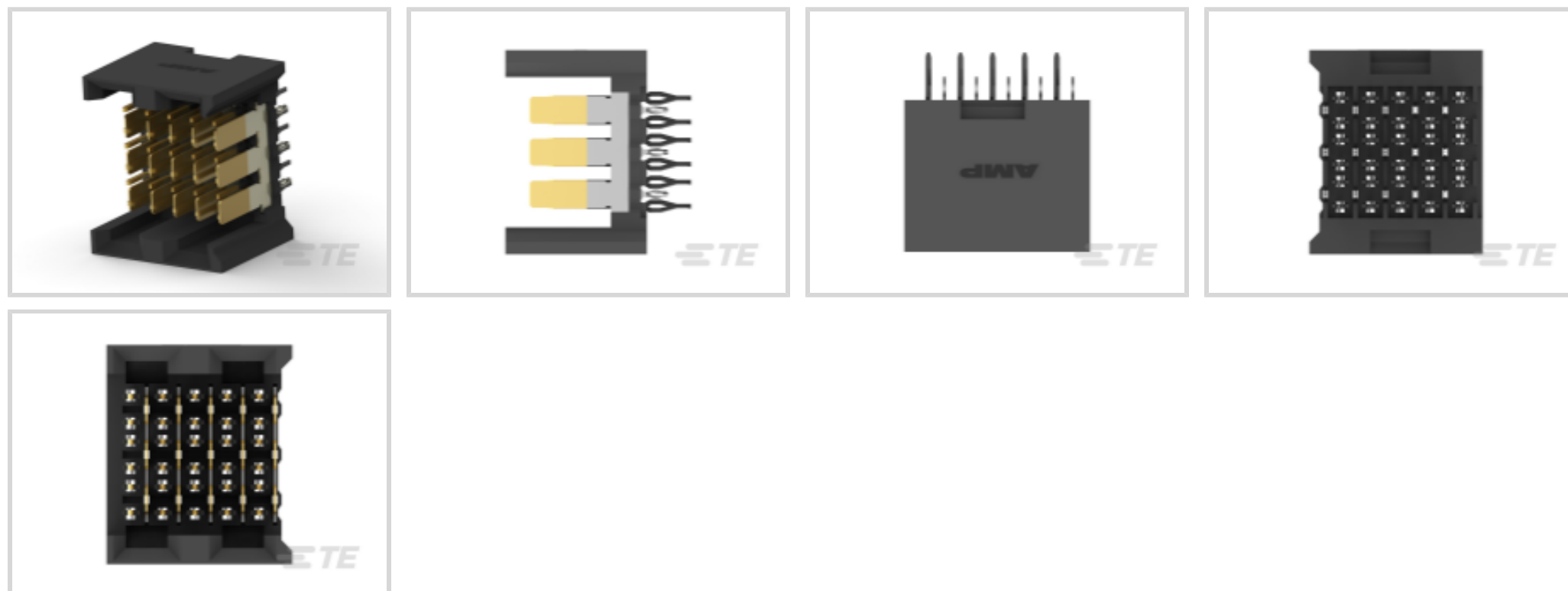
TE 内部编号 5120677-1

High Speed Backplane Connectors, 30 Position, Mating Alignment, Polarization Mating Alignment Type, 6 Row, 5 Column, PCB Mount Header, Z-PACK HS3

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器



位数: 30

行间距: 2 mm [ .078 in ]

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化, 极化

行数: 6

## 产品特性

### 产品类型特性

背板模块类型	右
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
护罩种类	部分带罩

### 结构特性

可堆叠	否
背板架构	传统背板
位数	30
行数	6
列数	5
PCB 安装方向	垂直

### 电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

### 信号特征

每列的差分对数量	3
----------	---

### 主体特性

导针种类	ESD/HDI
------	---------

主要产品颜色	黑色
--------	----

### 接触件特性

端子接触部长度	6.8 mm[.268 in]
---------	-----------------

端子类型	插针
------	----

端子接合区域电镀材料厚度	.5 $\mu$ m[19.68 $\mu$ in]
--------------	----------------------------

端子接触部电镀材料	锡
-----------	---

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
--------------------	----

端子形状和构造	双梁, 双梁
---------	--------

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	磷青铜
------	-----

端子额定电流 (最大值)	1.15 A
--------------	--------

### 端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.7 mm[.146 in]
------------	-----------------

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

### 机械附件

导轨硬件	不带
------	----

接合固定	不带
------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
------------	-----------

接合对准	带有
------	----

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

### 壳体特性

有带罩的边数	2 - 侧面
--------	--------

外壳材料	聚酯 - GF
------	---------

中心线 (间距)	2.5 mm[.098 in]
----------	-----------------

### 尺寸

连接器长度	14.46 mm[.569 in][.945 in]
-------	----------------------------



连接器高度	11.95 mm[.47 in]
连接器宽度	24 mm
PCB 厚度 (建议)	1.4 mm
PCB 孔直径	.05 mm[.001 in]
行间距	2 mm[.078 in]

### 使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Z-PACK HS3



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

Z-PACK HS3 HDR ASSY 6R 30P RH

英文版本

### CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5120677-1\_B.2d\_dxf.zip



英文版本

[3D PDF](#)

3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5120677-1\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5120677-1\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK HS3 Connector](#)

英文版本

**产品规格**

**应用规格**

英文版本